

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2026-003

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称/人员姓名	中信建投证券、西部证券、中银国际证券、国金证券、东方财富证券、富国基金、博时基金、华泰柏瑞基金、云杉常青基金、光大永明资产、前海再保险、诚朴资管、弥远投资、澜亭投资
时间	2026年2月5日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事：宋嘉斌 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 证券事务代表：陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍公司基本情况和发展历程。</p> <p>二、与调研机构的互动交流。</p> <p>公司与调研机构方互动交流的主要内容如下：</p> <p>Q1: 公司从智能卡业务延伸至液冷赛道的契机是什么？技术人才储备是否充足？客户合作进展如何？</p> <p>答：公司从智能卡业务延伸至液冷赛道，源于技术积累与产业趋势的自然演进。2018年公司投资宁波澄天专用芯片封装项目切入功率半导体封装材料领域，凭借在高导热金属材料、蚀刻、电镀、钎焊等工艺上的长期技术沉淀，自然延伸至液冷散热领域。在技术人才储备方面，公司已组建了一支兼具工艺开发与客户服务能力的专业团队，核心负责人拥有多年行业经验，并在惠州建立了研发与初步量产产线，当前人才储备可充分支撑业务的稳步推进。在客户合作进展上，公司液冷业务已通过台湾合作伙伴成功进入美系头部半导体公司供应链，为其提供液冷板、管路等核心零部件。同时，公司正积极开拓国内市场，与多家国内知名客户建立了合作关系，进一步提升了公司的市场竞争力。</p>

场，与头部服务器厂商及互联网企业开展合作，提供系统级液冷解决方案，目前相关样品测试与量产导入工作正有序推进。

Q2：公司液冷产品目前向台湾厂商提供的具体有哪些？

答：公司主要根据客户需求，提供液冷散热相关的核心零部件或组件。具体包括液冷板、不锈钢波纹管、接口、接头底座等。公司具备从机加工、焊接、组装到清洗检测的全流程制造能力，可根据客户的定制化需求，提供灵活的产品组合与解决方案。

Q3：目前液冷业务的产能基地在哪里？生产基地建设如何？

答：公司液冷业务的生产基地位于惠州，目前已通过自有资金完成首期建设，相关产线已具备满足现阶段客户交付需求。在 2026 年定增预案中，公司也计划将募集资金主要用于投入该基地的产能扩建，以进一步满足未来市场与客户增长需求。

Q4：液冷业务的下一代产品主要是什么？微通道技术（MLCP）的进展如何？

答：公司液冷业务的下一代重点研发方向是微通道封装盖板（MLCP），这是一种将液冷通道深度集成于封装材料内的芯片级高效散热解决方案，可大幅提升高热流密度场景下的散热效率。目前，MLCP技术方案正处于与客户联合研发和验证阶段，工艺路径仍在迭代优化，尚未完全定义。公司已向客户提交了相关样品，正同步推进测试与技术打磨工作。

Q5：当前液冷产品的良率如何？与客户的合作方式是怎样的？

答：受产品形态、工艺路线、验证阶段及客户规格差异影响，公司液冷产品良率在不同品类与不同项目上存在差异，整体处于从样品/小批量向规模化导入的爬坡阶段，并通过关键工序的过程能力提升与全流程检测持续改善。公司与客户的合作方式灵活，可根据其需求，以零部件供应商或ODM模式，提供从单个部件到焊接、组装的全流程产品与服务。

Q6：本次定增的产能规划是基于怎样的客户需求预测？项目的投资回报率是否有评估？

答：本次定增的液冷产能规划，是基于对液冷行业高景气发展趋势的判断，以及下游客户终端需求增长的审慎预判，同时也充分结合了公司现有核心客户的合作进展及未来订单需求，公司已对本次募投项目进行了可行性分析。首阶段规划产能将主要满足当前核心客户的交付需求。

Q7：除了台湾客户，公司是否接触其他客户？在液冷领域的竞争对手情况如何？

答：除台湾合作渠道对应的客户外，公司正积极开拓国内液冷市场，目前已与国内头部服务器厂商、互联网企业以及芯片设计公司进行接洽与合作推进，相关样品测试及量产导入工作正有序开展。液冷赛道目前参与者众多，各企业依托自身技术积淀形成了差异化的技术特点与竞争优势，行业整体竞争格局尚处于快速形成与优化阶段。

Q8：本次定增的产能是否能满足多家客户需求？客户为何选择与公司合作而非自行投建扩产？

答：本次定增规划的液冷产能，主要聚焦于满足核心战略客户的规模化交付需求。对于客户而言，在AI产业快速扩张的行业背景下，全球液冷供应链优质产能相对紧张，客户选择与公司合作，核心在于公司具备成熟的液冷核心工艺、和稳定的产能保障能力及快速的客户需求响应能力，相较自行投建扩产，更具效率和成本优势。

Q9：公司液冷产品中，价值量较高的核心部件是什么？

答：当前价值量较高的核心部件主要集中在液冷板、分水器以及快接头（含接头底座）等关键散热与连接部件；下一代研发重点为MLCP 微通道封装盖板，有望进一步提升单机价值量与技术壁垒。

Q10：公司智能卡业务 2026 年的展望如何？

答：智能卡业务已进入成熟期，预计将保持平稳发展态势。公司对该业务目前暂无新的扩产计划，未来将主要维持现有规模，并通过向超级SIM卡等服务方向升级以提升盈利水平。

Q11：公司半导体封装材料业务的增长趋势如何？是否受到原材料涨价影响？

	<p>答：公司半导体封装材料业务自 2023 年量产后持续增长，2024 年及 2025 年均保持同比上涨，对 2026 年的趋势仍保持乐观。近期铜、贵金属等原材料价格上涨确实对成本构成压力。公司已与主要客户建立了价格联动机制，共同应对成本波动，并通过内部成本优化策略尽可能缓解对利润的影响。</p> <p>Q12：公司未来是否有新的股权激励计划？</p> <p>答：公司会考虑实施新的股权激励计划，目前公司回购专用账户里仍有 100.51 万股，具体将根据引进核心技术人才及激励核心团队的节奏适时推进。</p> <p>Q13：募投项目中的研发中心投资主要方向是什么？</p> <p>答：研发中心投资将聚焦于液冷散热等新业务的研发课题，包括“微通道液冷板研发”“可控相变技术研发”等前沿技术。</p> <p>Q14：与SuperX合资公司的合作进展如何？</p> <p>答：公司与AI基础设施解决方案提供商SuperX于 2025 年 10 月在新加坡设立了合资公司，公司主要向合资公司提供自主研发生产的液冷模组及关键部件，由SuperX进行系统集成后，共同推向市场，最终销售给下游云计算服务器厂商。目前合资公司尚处于积极业务拓展阶段。</p>
风险提示	公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2026-2-5